



晶导微电子

Jingdao Microelectronics

RoHS 豁免声明

我司所有产品中的焊料&GPP 芯片所含有的 Pb,均属于 RoHS 豁免项目 (2011/534/EU)。

豁免条款如下：

- A. 焊料中的铅属于 RoHS 豁免项目。豁免条款为：7(a).高融化温度型焊料中的铅（即铅含量超过 85%的铅基合金焊料）；
- B. GPP 芯片中含有的高铅玻璃，其中的铅属于 RoHS 豁免项目。豁免条款为：
7(c)- I .电子电气元件中玻璃或陶瓷材料（电容中玻璃或陶瓷介质除外）所含的铅，如压电陶瓷设备或玻璃/陶瓷基混合物（复合元件）

当 RoHS 有新的指令对上述豁免重新定义或废除时，我们将另行申告，否则此申明一直有效。

山东晶导微电子股份有限公司

2019年6月19日

